

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱「業務 — 我們的戰略」。

### [編纂]用途

假設[編纂]未獲行使，在扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金及其他估計[編纂]開支，並假設[編纂]為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)後，我們預計將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元。

我們擬根據下文所載的戰略框架使用[編纂]，以確保每項開支均直接助力構建我們的長期競爭優勢及推動增長：

- [編纂]淨額約[編纂]%(約[編纂]港元)，預期未來五年用於前沿科技領域研發投入。我們將繼續加大研發投入，持續提升產品的性能和精度、拓展研發領域和產品組合以面向更廣的終端市場。請參閱「業務 — 我們的戰略 — 戰略投入新技術研發，增強技術領先優勢」及「業務 — 我們的戰略 — 持續完善高端產品矩陣，把握由人工智慧驅動的全球結構性成長」。具體而言：
  - (i) [編纂]淨額的約[編纂]%( [編纂]港元)將分配用於建立研發中心，配備全套基礎設備及各類研發實驗設備，設立電子、光學、機械實驗室，並搭載支撐研發系統的專屬軟件，實現軟硬件協同支撐平台研發工作。具體而言，我們計劃將[編纂]淨額主要投入(i)未來一年租賃實驗室，隨後開始自建和裝修實驗室，預期未來第二年開始運營；(ii)採購平台研發工作的實驗設備，包括電子、光學、機械實驗室相關設備，例如測試架、測試板、顯微鏡、8通道示波器、3D測量儀；(iii)購買支撐研發的系統軟件及相應基礎設施，例如雲軟硬件系統、冷卻系統、GPU計算節點。
  - (ii) [編纂]淨額的約[編纂]%( [編纂]港元)將分配用於強化我們的PCB檢測及檢驗基礎技術以及豐富我們PCB質量控制解決方案，以持續領跑行業領先水平。首先，我們將持續推進我們的高端PCB檢測技術的迭代升級，全面提升現有產品的性能和檢測精度。其次，我們將針對AIDC、下一代通信、低空經濟及其他新型領域開發專門的PCB質量控制解決方案。例如，我們計劃透過建立高速、高精度運動控制系統，提升檢測設備的技術水平。這將實現超大型PCB的穩定、全範圍檢測，並促進多層內部缺陷識別的突破，確保完全符合AI算力領域對高精度PCB所要求的嚴苛檢測標準。另外，我們將重點投入IC載板等高端PCB產品檢測設備的研發，確保我們的解決方案適用於

## 未來計劃及[編纂]用途

更高的佈線密度及整體厚度減少等先進製造要求。此外，我們將開發專用的光學成像解決方案，以克服與檢測透明基材相關的技術挑戰。為達到以上目的，我們計劃將[編纂]淨額主要投入委託市場調研、採購針對性的研究設備和機械、用針對性的測試設備建立技術性能測試和產品測試環境。我們還計劃招聘研發人員，我們未來五年總共計劃新招聘150名人員。

- (iii) [編纂]淨額的約[編纂]% ([編纂]港元) 將分配用於通過自主戰略研究及收購知識產權或擁有所需技術的第三方目標來增強我們的技術能力。我們計劃的重點研究領域包括(a) 2.5D-3D測量技術(目前2D技術的升級版)；(b)不可見光(輻射)技術(在現有可見光技術基礎上的發展)及(c)精密阻抗控制技術(即比傳統的阻抗控制技術具有更高的精度和信號頻率)。[編纂]淨額將主要用於委託市場調研、採購針對性的研究設備和機械、用針對性的測試設備建立技術性能測試和產品測試環境，並收購具吸引力的知識產權及目標。我們還計劃招聘研發人員，未來五年計劃新增聘用合共40名員工。
- (iv) [編纂]淨額的約[編纂]% ([編纂]港元) 將分配用於晶圓和半導體產品檢測設備的研發。[編纂]淨額將主要用於市場研究、研發設備採購及研發材料購置。我們還計劃招聘研發人員，未來五年計劃新增聘用合共50名員工，負責研究、技術及軟件開發。
- [編纂]淨額的約[編纂]% (約[編纂]港元)，將用於在未來五年在中國擴充我們PCB及子板精密檢測設備的產能，以把握不斷增長的市場機遇及支持未來業務增長。請參閱「業務 — 我們的戰略 — 擴充產能以支持可持續增長」。根據灼識諮詢的資料，全球PCB質量控制解決方案行業的市場規模已由2020年的人民幣59億元增至2025年的人民幣90億元，年複合增長率達8.9%，預期到2030年將達到人民幣148億元，年複合增長率達10.3%。請參閱「行業概覽 — 全球PCB質量控制解決方案行業分析 — 全球PCB行業發展背景」。具體而言：
  - (i) [編纂]淨額的約[編纂]% ([編纂]港元) 將分配用於採購生產、加工和檢測設備。[編纂]淨額將主要用於(i)採購生產設備，尤其是高精度進口設備(如探針台生產設備)；(ii)採購光學、電子和機械性能及精度檢測設備(如3D成像儀及3D檢測儀)；(iii)採購高精度部件機械加工設備，包括高精度數控臥式加工中心及高精度數控鏜銑床。
  - (ii) [編纂]淨額的約[編纂]% ([編纂]港元) 將分配用於採購原材料及消耗品，主要包括電子材料、光學材料、機械零件及標準件。

## 未來計劃及[編纂]用途

- (iii) [編纂]淨額的約[編纂]% (約[編纂]港元) 將分配用於擴充生產設施，包括租賃及自建計劃。具體而言，我們計劃在未來三年租賃生產場地，相關[編纂]將分配用於支付租金和相關生產廠房翻新工程。同時，我們計劃建設一個集生產、研發、辦公及住宿設施於一體的綜合產業園，預計將於五年期間中的第四年投入運營。[編纂]淨額將主要用於獲取土地使用權、建造主要生產廠房、採購機電及消防系統，以及購置環保及其他配套設施。
- (iv) [編纂]淨額的約[編纂]% (約[編纂]港元) 將分配用於招聘生產人員及其他支持員工。我們計劃在未來五年新增聘用325名生產員工以及120名其他支持員工 (例如生產技術員、IT人員及物流人員)，以支持生產運營。
- [編纂]淨額約[編纂]% (約[編纂]港元)，預期未來五年用於加強銷售網絡建設。請參閱「業務 — 我們的戰略 — 全面升級客戶服務質量，提升客戶黏性和品牌知名度」。一方面，在印度、泰國、越南、日本及韓國等地區將加強我們的海外產品銷售及營銷能力，完善全球經銷渠道和銷售網絡。[編纂]淨額將主要投入於(i)招募具有全球視野及海外經驗的銷售代表及銷售經理。具體而言，我們計劃在未來五年招聘約70到90名銷售人員，負責海外市場的市場開發與客戶獲取、客戶關係管理以及合同與訂單處理。應聘者需要有至少3年相關經驗，具備能獨立完成招攬客戶的能力，並要求英語流利；(ii)設立產品展示廳；(iii)參加當地的產品展覽會及會議，幫助我們更高效地與當地客戶及供貨商進行業務洽談。另一方面，我們將擴展專注於技術及備件支持的售後服務團隊，並為相關的售後活動撥出[編纂]淨額，以確保及時響應當地客戶需求，從而提升客戶忠誠度及品牌認知度。[編纂]淨額將主要投入於在未來五年招聘約175名售後客服人員，負責售後維護工作。
  - [編纂]淨額約[編纂]% (約[編纂]港元)，預期將用於補充營運資金及一般企業用途。

倘若[編纂]定於指示性[編纂]範圍的最高或最低[編纂]，[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。

倘[編纂]獲悉數行使，我們可獲得的額外[編纂]淨額將分別為：(i)約[編纂]港元 (假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍最高[編纂])；(ii)約[編纂]港元 (假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍中位[編纂])；或(iii)約[編纂]港元 (假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍最低[編纂])。

倘若[編纂]淨額多於或少於預期，我們將按比例調整上述用途的[編纂]分配。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

倘若[編纂]淨額未能即時用於上述用途，我們僅會在認為此舉符合我們的最佳利益的情況下，將該等款項存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區適用法律及法規)的短期計息銀行賬戶。在此情況下，我們將遵守《上市規則》的適當披露規定。

倘若我們的發展計劃的任何部分因政府政策變動等原因導致任何項目的開發受阻，或因不可抗力事件等原因未能按計劃進行，董事將審慎評估相關情況，並可能重新分配[編纂]淨額。